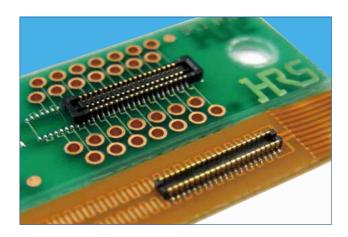
0.4mm ピッチ 高さ0.6、0.8mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

BM20シリーズ



■特長

1. セットの高密度実装に貢献

実装性に影響を及ぼさない吸着エリア(DP.DS 0.7mm以上) を確保しながら(実装確認済)、コネクタ奥行きを最小限に 留める省スペース設計です。

奥行きDS:2.3mm DP:1.78mm

2. 高い接触信頼性

各嵌合高さにおいて最長クラスの有効嵌合長を有しています。 <有効嵌合長>

> 高さ0.8mm: 0.2mm 高さ0.6mm: 0.15mm

また、2点接触構造を採用することにより、高い接触信頼性 を確保しています。

3. パターン禁止エリア無し(高さ0.8mm)*1

薄肉成形技術により、有効嵌合長0.2mmを保ちながらも、 コネクタ下面と基板の絶縁が完全に取れている為、パターン 設計に制約がありません

注*1:H=0.6mmについては、絶縁エリアの指定がございます。

4. 良好な嵌合操作性

ガイドリブにより、嵌合セルフアライメント0.3mmを確保してい ます。

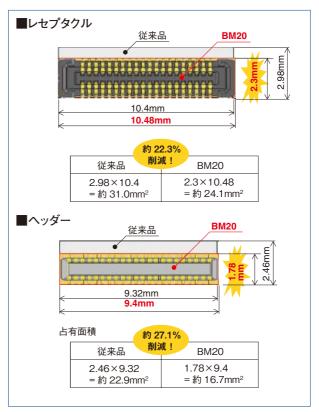
また、半嵌合防止に有効なクリック感を有しており、嵌合 操作性向上に貢献します。

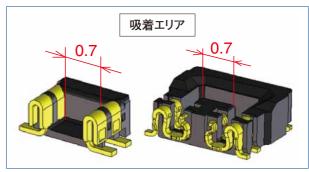
5. 衝撃吸収端子による堅牢構造

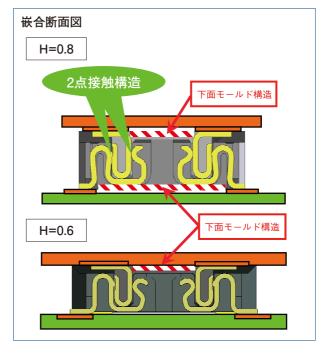
プラグ端子に設けたロック機構により、衝撃時の応力を吸収 します。

6. 飛沫物回避の安心構造

接触部が両コネクタとも壁に覆われている為、フラックス等の 飛沫物が接触部への付着を防ぎます。







■製品規格

項目	規格	条件
1.絶縁抵抗	50MΩ以上	DC 100Vで測定
2.耐電圧	せん絡・絶縁破壊がないこと	AC 100Vを1分間通電
3.接触抵抗	100mΩ以下	AC20mV、1kHz、1mAで測定
4.耐振性	1μs以上の瞬断がないこと	周波数 10~55Hz、片振幅 0.75mm、3方向 2時間
5.耐湿性	接触抵抗100mΩ以下、絶縁抵抗 25MΩ以上	温度 40±2℃、湿度 90~95%、96時間放置
6.温度サイクル	接触抵抗100mΩ以下、絶縁抵抗 50MΩ以上	(-55°C:30分→5~35°C:10分→85°C:30分→5~35°C:10分) 5サイクル
7.挿抜寿命	接触抵抗100mΩ以下	挿抜10回
8.半田耐熱性	性能に影響する樹脂部の溶解がないこと	リフロー:推奨温度プロファイルにて、 手半田:半田ごて温度 350℃、3秒以内

⁽注1)通電時の温度上昇を含みます。

■材質

製品	部品	材質	処理	UL規格
レセプタクル	絶縁物	LCP	黒 色	UL94V-0
ヘッダー	端子	りん青銅	金めっき	

■製品番号の構成

製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

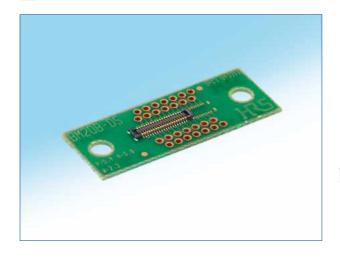
●レセプタクル/ヘッダー

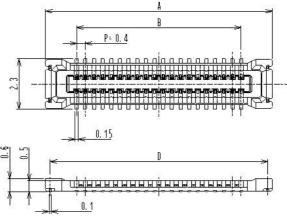
BM	20	#	(**)	_	*	DS	_	0.4	V	(51)
•	2	8	4		6	6		7	8	9

● シリーズ名:BM	6 コネクタ種別
② シリーズNo.: 20	DS:ダブルロウレセプタクル
❸ 形状記号	DP:ダブルロウヘッダー
B:補強金具有り	7 コンタクトピッチ: 0.4mm
④ スタック:0.6mm、0.8mm	❸ ターミナル形状V:ストレートSMT
5 極数: P.3~の表をご参照ください。	⑨ 梱包形態
	(51): エンボステープ梱包(8000個/リール)

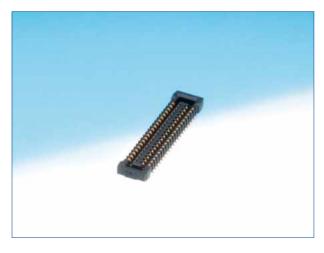
⁽注2)ここで言う保存とは、基板実装前の未使用品に対する長期保管状態を表します。 基板実装後の無通電状態及び、輸送時などの一時保管状態では、使用温湿度範囲が適用されます。

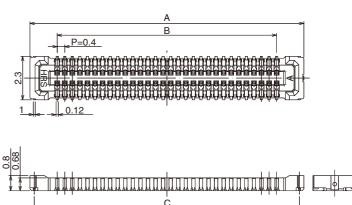
■H=0.6mmレセプタクル



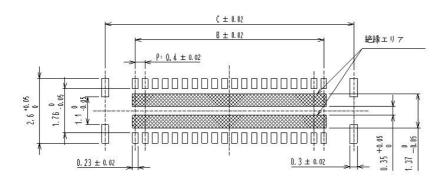


■H=0.8mmレセプタクル

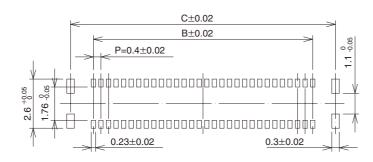




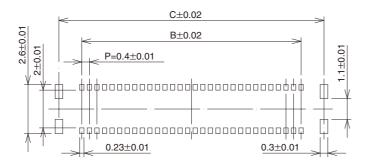
●推奨基板パターン図【H=0.6mm】



●推奨基板パターン図【H=0.8mm】



●推奨メタルマスク寸法(マスク厚100μm)【0.6mm、0.8mm共通】



単位:mm

						, ,
製品番号	HRS No.	極数	А	В	С	D
BM20B(0.6)-10DS-0.4V(51)	0684-9308-8 51	10	4.48	1.6	4.02	4.06
BM20B(0.6)-20DS-0.4V(51)	0684-9309-0 51	20	6.48	3.6	6.02	6.06
BM20B(0.6)-24DS-0.4V(51)	0684-9310-0 51	24	7.28	4.4	6.82	6.86
BM20B(0.6)-30DS-0.4V(51)	0684-9311-2 51	30	8.48	5.6	8.02	8.06
BM20B(0.6)-34DS-0.4V(51)	0684-9312-5 51	34	9.28	6.4	8.82	8.86
BM20B(0.6)-40DS-0.4V(51)	0684-9313-8 51	40	10.48	7.6	10.02	10.06
BM20B(0.6)-50DS-0.4V(51)	0684-9314-0 51	50	12.48	9.6	12.02	12.06
BM20B(0.6)-60DS-0.4V(51)	0684-9315-3 51	60	14.48	11.6	14.02	14.06

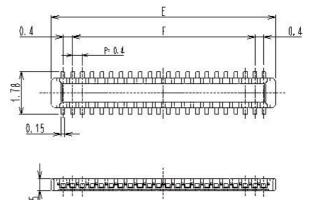
製品番号	HRS No.	極数	Α	В	С
BM20B(0.8)-10DS-0.4V(51)	0684-9008-4 51	10	4.48	1.6	4.02
BM20B(0.8)-16DS-0.4V(51)	0684-9041-0 51	16	5.68	2.8	5.22
BM20B(0.8)-20DS-0.4V(51)	0684-9009-7 51	20	6.48	3.6	6.02
BM20B(0.8)-24DS-0.4V(51)	0684-9010-6 51	24	7.28	4.4	6.82
BM20B(0.8)-30DS-0.4V(51)	0684-9011-9 51	30	8.48	5.6	8.02
BM20B(0.8)-34DS-0.4V(51)	0684-9020-0 51	34	9.28	6.4	8.82
BM20B(0.8)-40DS-0.4V(51)	0684-9012-1 51	40	10.48	7.6	10.02
BM20B(0.8)-50DS-0.4V(51)	0684-9013-4 51	50	12.48	9.6	12.02

⁽注1)エンボステープ梱包品は、リール数にてご注文ください。

⁽注2)本コネクタに極性はございません。

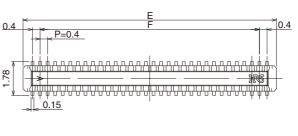
■H=0.6mm ヘッダー

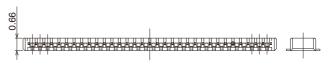




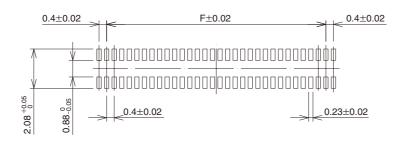
■H=0.8mm ヘッダー



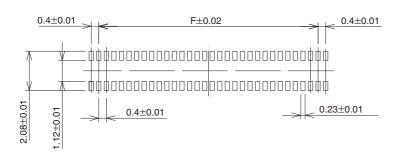




●推奨基板パターン図【0.6mm、0.8mm 共通】



●推奨メタルマスク寸法(マスク厚100µm)【0.6mm、0.8mm共通】



単位:mm

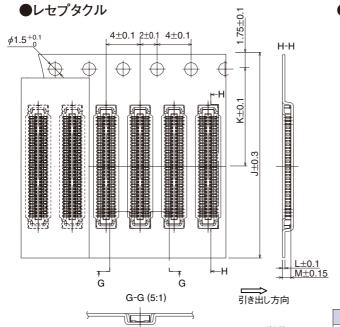
製品番号	HRS No.	極数	Е	F
BM20B(0.6)-10DP-0.4V(51)	0684-9300-6 51	10	3.4	1.6
BM20B(0.6)-20DP-0.4V(51)	0684-9301-9 51	20	5.4	3.6
BM20B(0.6)-24DP-0.4V(51)	0684-9302-1 51	24	6.2	4.4
BM20B(0.6)-30DP-0.4V(51)	0684-9303-4 51	30	7.4	5.6
BM20B(0.6)-34DP-0.4V(51)	0684-9304-7 51	34	8.2	6.4
BM20B(0.6)-40DP-0.4V(51)	0684-9305-0 51	40	9.4	7.6
BM20B(0.6)-50DP-0.4V(51)	0684-9306-2 51	50	11.4	9.6
BM20B(0.6)-60DP-0.4V(51)	0684-9307-5 51	60	13.4	11.6

製品番号	HRS No.	極数	Е	F
BM20B(0.8)-10DP-0.4V(51)	0684-9001-5 51	10	3.4	1.6
BM20B(0.8)-16DP-0.4V(51)	0684-9040-7 51	16	4.6	2.8
BM20B(0.8)-20DP-0.4V(51)	0684-9002-8 51	20	5.4	3.6
BM20B(0.8)-24DP-0.4V(51)	0684-9003-0 51	24	6.2	4.4
BM20B(0.8)-30DP-0.4V(51)	0684-9004-3 51	30	7.4	5.6
BM20B(0.8)-34DP-0.4V(51)	0684-9019-0 51	34	8.2	6.4
BM20B(0.8)-40DP-0.4V(51)	0684-9005-6 51	40	9.4	7.6
BM20B(0.8)-50DP-0.4V(51)	0684-9006-9 51	50	11.4	9.6

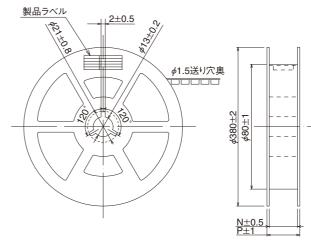
⁽注1)エンボステープ梱包品は、リール数にてご注文ください。

⁽注2)本コネクタに極性はございません。

●エンボステープ寸法図(JIS C 0806準拠)



●リール状態寸法図

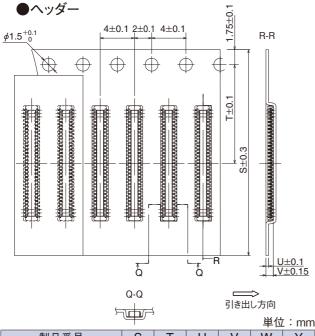


単位:mm

	'				単位	<u>z:mm</u>
製品番号	J	K	L	М	N	Р
BM20B(0.6)-10DS-0.4V(51)	16	7.5	0.25	0.8	17.5	21.5
BM20B(0.6)-20DS-0.4V(51)	16	7.5	0.25	0.8	17.5	21.5
BM20B(0.6)-24DS-0.4V(51)	16	7.5	0.25	0.8	17.5	21.5
BM20B(0.6)-30DS-0.4V(51)	24	11.5	0.25	0.8	25.5	29.5
BM20B(0.6)-34DS-0.4V(51)	24	11.5	0.25	0.8	25.5	29.5
BM20B(0.6)-40DS-0.4V(51)	24	11.5	0.25	0.8	25.5	29.5
BM20B(0.6)-50DS-0.4V(51)	24	11.5	0.25	0.8	25.5	29.5
BM20B(0.6)-60DS-0.4V(51)	24	11.5	0.25	0.8	25.5	29.5

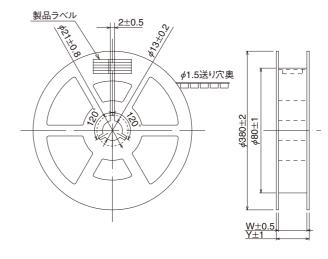
製品番号	J	K	L	М	N	Р
BM20B(0.8)-10DS-0.4V(51)	16	7.5	0.3	1	17.5	21.5
BM20B(0.8)-16DS-0.4V(51)	16	7.5	0.3	1	17.5	21.5
BM20B(0.8)-20DS-0.4V(51)	16	7.5	0.3	1	17.5	21.5
BM20B(0.8)-24DS-0.4V(51)	16	7.5	0.3	1	17.5	21.5
BM20B(0.8)-30DS-0.4V(51)	24	11.5	0.3	1	25.5	29.5
BM20B(0.8)-34DS-0.4V(51)	24	11.5	0.3	1	25.5	29.5
BM20B(0.8)-40DS-0.4V(51)	24	11.5	0.3	1	25.5	29.5
BM20B(0.8)-50DS-0.4V(51)	24	11.5	0.3	1	25.5	29.5

●エンボステープ寸法図(JIS C 0806準拠)



					単位	: mm
製品番号	S	Т	U	V	W	Υ
BM20B(0.6)-10DP-0.4V(51)	12	5.5	0.25	0.65	13.5	17.5
BM20B(0.6)-20DP-0.4V(51)	16	7.5	0.25	0.65	17.5	21.5
BM20B(0.6)-24DP-0.4V(51)	16	7.5	0.25	0.65	17.5	21.5
BM20B(0.6)-30DP-0.4V(51)	16	7.5	0.25	0.65	17.5	21.5
BM20B(0.6)-34DP-0.4V(51)	24	11.5	0.25	0.65	25.5	29.5
BM20B(0.6)-40DP-0.4V(51)	24	11.5	0.25	0.65	25.5	29.5
BM20B(0.6)-50DP-0.4V(51)	24	11.5	0.25	0.65	25.5	29.5
BM20B(0.6)-60DP-0.4V(51)	24	11.5	0.25	0.65	25.5	29.5

●リール状態寸法図



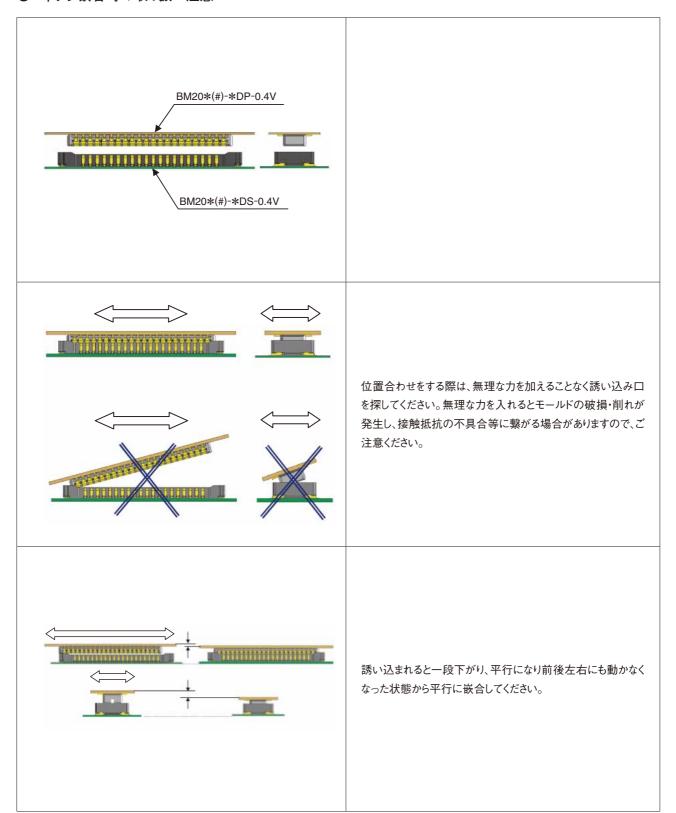
単位:mm

製品番号	S	Т	U	V	W	Υ
BM20B(0.8)-10DP-0.4V(51)	12	5.5	0.3	0.88	13.5	17.5
BM20B(0.8)-16DP-0.4V(51)	16	7.5	0.3	0.88	17.5	21.5
BM20B(0.8)-20DP-0.4V(51)	16	7.5	0.3	0.88	17.5	21.5
BM20B(0.8)-24DP-0.4V(51)	16	7.5	0.3	0.88	17.5	21.5
BM20B(0.8)-30DP-0.4V(51)	16	7.5	0.3	0.88	17.5	21.5
BM20B(0.8)-34DP-0.4V(51)	16	7.5	0.3	0.88	17.5	21.5
BM20B(0.8)-40DP-0.4V(51)	24	11.5	0.3	0.88	25.5	29.5
BM20B(0.8)-50DP-0.4V(51)	24	11.5	0.3	0.88	25.5	29.5

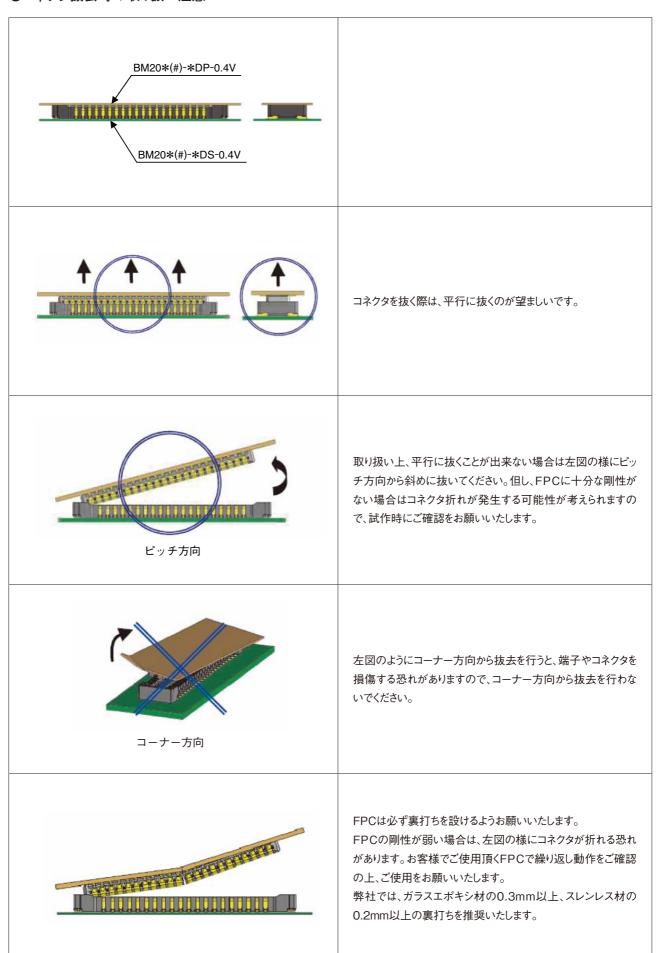
●使用上のご注意

1. 推奨温度プロファイル	
	温度 (°C) 250°C
	【適用条件】 1.ピーク温度:250℃ピーク 2.加熱部:220℃以上、60sec以内 3.予熱部:150~180℃、90~120sec 4.回数:2回以内 (注1)温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表わします。 (注2)窒素リフロー御使用の場合は、酸素濃度を1000[ppm]以上で実装お願い致します。 1000[ppm]未満の場合はお問い合わせください。
2. 推奨手はんだ条件	はんだごて温度 340±10℃、はんだ時間 3秒以内
3. 推奨スクリーン厚さ・開口率(パターン面積比)	厚さ: 0.1mm 開口率: DS側70% DP側80%
4. 基板の反り	コネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にてMax0.02mm
5. 洗浄	推奨出来ません。洗浄する場合は、ご評価の上ご使用ください。 (洗浄により挿抜性、耐環境性に変化が生じる場合があります。)
6. 注意事項	 ■基板実装されていない状態での挿抜は、破損、端子の変形等の原因となりますのでご注意ください。 ■コネクタのみで基板を支えることは避け、コネクタ以外での基板固定対策を行ってください。 ■過度なこじり挿抜は、破損の原因となりますのでご注意ください。 ■手はんだの際は、コネクタのフラックス上がりの原因となるフラックスの塗布は行わないでください。 ■本製品は製造ロットにより、成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、性能には影響ありません。 ■挿抜時に於ける取り扱い上の注意事項は次頁をご参照ください。 ■落下・衝撃、FPCの取り回しによる反力により嵌合が外れる場合がありますので、筐体やクッション材等で嵌合方向への押さえによる固定を行ってください。

●コネクタ嵌合時の取り扱い注意



●コネクタ抜去時の取り扱い注意



MEMO:	

MEMO:

ヒロセ電機株式会社 営業本部 神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号 https://www.hirose.com/